



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

OBSOLETE		Y	△6 △4	2-316132-5
			△6 △3	2-316132-3
			△6 △2	2-316132-2
		X	△6 △4	1-316132-5
			△6 △3	1-316132-3
			△6 △2	1-316132-2
	キーイング位置 KEYING LOCATION	キーイング KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				TE Connectivity			
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME			
mm(AWG -)		mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 5 極 ヘッダーアセンブリー			
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 5 POS.HDR CONN.ASS'Y			
SEE NOTES 注記参照		SEE NOTES 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
DR. 26/JUL/95		DE. 26/JUL/95		SIZE	LOC	NUMBER	
K.IKEDA		K.IKEDA		A3	J	C-316132	
CHK. 2/AUG/95		APP. 2/AUG/95		SCALE	REV.	SHEET	
Y.ISHIKAWA		S.MANABE		2-1	C	1 OF 1	
LTR REVISION RECORD		DR	CHK	DATE			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-316132-2](#)